

股票代码：688403

股票简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年6月12日)

编号：2024-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	宝盈基金、泉果基金、华福证券
活动时间	2024年6月12日
活动地点	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 奚颢 财务总监 闫柳 证券事务代表 王赞
投资者关系活 动主要内容 介绍	<p>1、问：公司 DDIC 下游具体应用领域近期的景气度情况怎么样？</p> <p>答：从下游应用景气度趋势来看，2024年上半年受益于年内体育赛事等因素影响，下游高清电视等大尺寸显示驱动芯片终端需求旺盛；小尺寸显示驱动芯片中部分新型应用场景的品类在近期呈现快速增长态势，如电子标签、电子烟、智能穿戴、智能家居等。</p> <p>2、问：不同类型的显示面板所使用的驱动芯片在封测技术方面主要区别是什么？</p> <p>答：LCD、OLED、TDDI 等不同类型的 DDIC 产品晶圆的</p>

	<p>制程和性能有所不同，而所使用的封测制程工艺原理相似，在封测端的主要区别在于 OLED 及部分 TDDI 等高端制程产品需要使用非接触式镭射切割（Laser grooving）技术，并且对测试机台的测试频率、测试 pin 数量等性能指标要求较高。</p> <p>3、问：公司如何展望 OLED 驱动芯片封测业务今年的趋势？</p> <p>答：根据下游客户端的反馈，终端市场的 OLED 显示屏渗透率持续提升，部分客户新款 OLED 显驱芯片逐步推向市场，今年下半年公司 OLED 产品封测业务收入占比有望进一步提升。</p> <p>4、问：公司中小尺寸显示屏驱动 IC 的增长情况怎么样？</p> <p>答：整体而言，今年上半年 DDIC 封测行业大尺寸品类的景气度好于中小尺寸，中小尺寸品类中电子价签、电子烟、智能家居等新型品类增长速度较快。展望下半年，随着人机交互应用场景的持续增长以及部分品类市场需求的推动，新型品类中小尺寸 DDIC 有望进一步实现成长；同时，随着手机新机发布及备货增加，有望带动中小尺寸 DDIC 景气度实现提升。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>上传日期</p>	<p>2024 年 6 月 13 日</p>